



LOTPASTE SC BLF01

Typ ISO 1.2.3.C

SC BLF 01 ist ein Spitzenprodukt der Lötstoffindustrie für die gehobenen Ansprüche in **bleifreien** SMT-Anwendungen. Fundierte Kenntnisse, in Chemie und SMT, liegen dieser zukunftsweisenden Entwicklung zugrunde und bürgen für die höchste Qualität dieses Produktes.

Die synthetische Harzbasis garantiert: **keine Lötperlen im Allgemeinen und keine Sideballbildung** an passiven Bauteilen.

Die SC BLF 01 zeichnet eine **hervorragende Konturenstabilität** aus. Nicht nur bei Raumtemperatur, sondern auch in der Aufheizphase. Somit werden uneingeschränkt erfolgreiche **Fine und Superfine Pitch** – Anwendungen zum „Regelfall“ in der Produktion.

Eine **gleichbleibend hervorragende Druckqualität** dank hoher Druckfestigkeit ist gewährleistet, vom ersten bis zum letzten Druck, auf allen konventionellen Drucksystemen und allen geschlossenen Rakelsystemen, wie **Proflow, Rheomatic Pumphead und Crossflow**.

Nach dem Löten bildet sich ein glasartiger Rückstand, der sich nicht auf der Lotoberfläche, sondern an den Loträndern sammelt. Das gewährleistet einen **problemlosen „In-Circuit-Test“!**

Synthetische Harze bieten außerdem den Vorteil, dass sie **nie die Reflowssysteme mit sog. „teerigen Rückständen“ verschmutzen**, da sie entgegen den Natur- und modifizierten Naturharzen keine Krackprodukte bilden, aufgrund ihrer wesentlich größeren Temperaturstabilität.

Die SC BLF 01 ist nicht nur nach dem Löten **absolut halogenfrei**, sondern schon **frei von allen Halogenverbindungen** in der Lotpaste selbst, was höchste S.I.R.-Werte und keine Elektrokorrosion der Lötstellen liefert.

SC BLF 01 ist auf allen gängigen **Reflowanlagen** problemlos, mit besten Lötsergebnissen zu verarbeiten und mit einem überragenden „Antigrabsteineffekt“. Eine **lange Verarbeitungszeit** während der gesamten Produktion ist sichergestellt.

Die SC BLF01 ist, wie alle SMT-Lotpasten, eine homogene Mischung aus Weichlotpulver, mit einem **synthetischen**, organischen Bindemittel. Als Lötmetall stehen **alle bleifreien Lote** im Schmelzbereich von 215°C bis 260°C zur Verfügung. Selbstverständlich sind nicht nur Lotpulver der Klasse III, sondern auch der Klassen IV und V verfügbar. **Bleifreie Legierungen** lassen sich, trotz der höheren Schmelztemperaturen, besonders gut mit einem **synthetischen Bindemittel** verarbeiten.

Die **synthetische Basis** garantiert eine gleichbleibende Qualität, die mit den natürlichen oder modifizierten Naturharzen unmöglich ist.

Metalllegierungen

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	<u>Schmelzpunkt</u>	Gemäß Internationalen Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:	
Sn96,5/Ag3,5	221°C	Kl.3	25 – 45 µm
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	217 – 219°C	Kl.4	20 – 36 µm
Sn96,5/Ag3/Cu0,5	217°C	Kl.5	10 – 25 µm
Sn99,3/Cu0,7	227°C		

Allgemeine Physikalische Daten

<u>Viskosität:</u> *		Konturenstabilität – DIN 32513		Solderballing	Benetzung
		Sofort	20min 80°C	nach IPC	nach IPC
750 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2		
900 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3	1	1

*Die Angaben beziehen sich auf die Messung mit dem Brookfield RVT-DV-II Viskosemeter, Spindel TF 5R/pm, bei 25°C mit dem Heliopath-System (+/- 10%). Paste = 90% Metallgehalt.

Oberflächenwiderstand nach IPC 650

Messungen am:

4.Tag - $3,2 \times 10^{13}$

21.Tag - $5,3 \times 10^{13}$

Die Lotpaste SC BLF 01 bleifrei entspricht den allgemeinen alten und neuen Normen wie DIN 32513, ISO, EN29454 sowie der IPC 650. Nicht nur die Rückstände, sondern auch die gesamte organische Zusammensetzung, entspricht der Klassifizierung nach EN 29454 1.2.3.

Handhabung und Lagerung

Nach Entnahme der Paste das Gebinde möglichst dicht verschließen. Alte Paste gehört nicht zur frischen und sollte gesondert aufbewahrt werden. Solange kein Flussmittel auf der Oberfläche zu sehen ist, muss die Paste nicht homogenisiert werden.

Niemals die SC BLF 01 mit anderen Pasten mischen, die gesamten positiven Eigenschaften der synthetischen Paste gehen verloren.

Die Lotpaste muss vor dem Rakel **rollen**, nur so kann jeder Druck gelingen. Für Fine Pitch Anwendungen ist eine Schablone unbedingt notwendig, genauso wie die Einstellung der Paste mit 90% Metallpulver.

Reinigungsmedien für die Reinigung der Schablone dürfen auf keinen Fall in die Paste gelangen. Es wird deswegen dringend empfohlen den **SC-Schablonenreiniger** zu verwenden.

Verschlossene Gebinde dürfen bei Raumtemperatur (ca. 23°C) gelagert werden! Eine Kühlschrankschlagerung ist selbstverständlich auch möglich, aber nicht zwingend erforderlich!

Verpackungen:

Dosen : 200g; 500g; 1000g ; Kartuschen: 600g; 1200g ;

Proflow- Kassette und Puckpack-Kassette.

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut

Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020

e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.